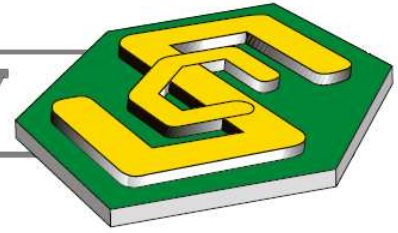


SOLDER CHEMISTRY



LOTPASTE SC BLF04

Typ RE L0

Die Lotpaste **SOLDER CHEMISTRY BLF 04** ist als neustes Produkt gezielt für alle sogenannten **bleifreien SMT-Anwendungen** entwickelt worden. Obwohl dank der Anwendung von modernen chemischen Mitteln wie Kunststoffen und –harzen, Aktivatorensystemen etc. alle unsere bisherigen Lotpasten von Anfang an sehr gut mit den bleifreien Legierungen kombinierbar waren, haben die letzten Erkenntnisse beim „Bleifreilöten“ zu dieser Neuentwicklung beigetragen. Eine sorgfältige und strenge Beachtung der Richtlinien von ISO-, EN-, IPC- und MIL-Normen lag auch ihr selbstverständlich zugrunde.

Die **BLF 04** ist physikalisch gesehen eine gleichmäßige Mischung aus einem **bleifreien Lotpulver**, in allen erforderlichen Legierungen und Körnungen lieferbar, mit einem organischen Bindemittel auf **Kunstharzbasis**, das der Kl. RE L0 nach J-STD-005 oder RMA-Qualifizierung entspricht.

Außer der hervorragenden Konturenstabilität, keiner Lotkugel- oder Spritzerbildung, einer langzeitigen Verarbeitbarkeit und langen Standzeit, sowie hoher Temperaturstabilität, zeichnen diese Paste folgende Vorteile aus:

- * **BLF 04*** Exzellente Resistenz gegen Feuchtigkeit. Sehr lange Klebrigkeit!!!
- * **BLF 04*** Bildet sehr homogene, lunkerfreie Lötstellen!
- * **BLF 04*** Eine hervorragende Druckqualität, stundenlang! Stabile Viskosität.
- * **BLF 04*** Eine feststoffarme Paste mit nur 5,8% Rückstand bei 89% Metallgehalt.
- * **BLF 04*** Die Rückstände entsprechen der RE L0 Klassifizierung.
- * **BLF 04*** Hinterlässt keine teerartigen Rückstände in der Lötanlage.
- * **BLF 04*** Lötet problemlos auch auf leicht korrodierten Oberflächen.

PHYSIKALISCHE DATEN

<u>Bevorzugte Legierungen</u>	<u>Schmelzpunkt</u>	Gemäß Internationalem Standard liefern wir diese Legierungen in den Klassen:
Sn96,5/Ag3,5	221°C	
Sn95,5/Ag3,8/Cu0,7	217 - 219°C	Kl.3 (T3) 25 - 45 µm
Sn96,5/Ag3/Cu0,5	217°C	Kl.4 (T4) 20 - 35 µm
Sn99,3/Cu0,7	227°C	Kl.5 (T5) 10 - 25 µm
Sn97/Cu3	227 - 300°C	

VISKOSITÄT (Pa.S) ± 10% gemessen nach Brookfield RVT–DV II Viskosimeter mit 89% Metallgehalt:

<u>Viskosität:*</u>		Konturenstabilität – DIN 32513		Solderballing	Benetzung
		Sofort	20min 80°C	nach IPC	nach IPC
600 Pas	Pulverklasse III	Kl.1 = 0,2	0,2		
650 Pas	Pulverklasse IV	Kl.2 = 0,2	0,3	1	1

OBERFLÄCHENWIDERSTAND (SIR) und elektrolytische Korrosionswirkung nach DIN 32513

Messung am 4.Tag 21.Tag
 3,7 x 10¹¹ 2,9 x 10¹¹

QUALIFIKATIONEN

Die Lotpaste **BLF 04** ist eine RMA-Paste die den Anforderungen der MIL-QQ-S571e entspricht. Der Korrosions-, Lotkugel- und der Benetzungstest sowie die Konturenstabilitätsprüfung (nach DIN 32513) wurden bestanden. Laboruntersuchungen bestätigen korrosionsfreie, der RE L0 entsprechende, Rückstände, die auf der Leiterplatte verbleiben können.

VERBRAUCHERHINWEISE

Nach Entnahme der Paste, das Gebinde möglichst dicht verschließen. Die benutzte Paste soll nicht mit der frischen zusammen aufbewahrt werden. Im laufenden Arbeitsprozess darf selbstverständlich neue Paste der älteren zur Auffrischung zugeführt werden. Verschiedene Lotlegierungen und Pastentypen sollte man nicht vermischen.

Empfohlene Rakelgeschwindigkeit: 15 – 100 mm/s.

Merke! Der Pastendruker ist immer schneller als der schnellste Bestücker in der Linie.

Das Wichtigste ist, daß die Paste beim Drucken am Rakel abrollt.

Für Schablonendruck wird eine Paste mit 90% Metallgehalt empfohlen.

Die Reinigung der Schablone kann mit einer Alkoholmischung erfolgen, aber das Reinigungsmedium darf unter keinen Umständen mit der Paste in Verbindung kommen.

Wir empfehlen daher den SC Schablonenreiniger. Die Lotpaste ist mit allen gängigen Reflow-Systemen aufschmelzbar.

LAGERUNG

Ungeöffnetes Gebinde – Dosen(!) bei ca. 20°C (RT): 6 Monate

Im geöffneten Zustand bzw. am Rakel der Druckeinrichtung ist die max. Verarbeitungszeit, abhängig von den Umwelteinflüssen denen die Paste ausgesetzt wird. **Eine Lagerung im Kühlschrank ist nicht notwendig!**

So bestellen Sie Ihre Solder Chemistry Paste:

<u>Legende</u>	<u>Pastentyp</u>	<u>Korngröße</u>	<u>Legierung</u>	<u>Flußmittelanteil</u>	<u>Gebindegröße</u>
z.B.	BLF 04	T3	96,5/3,0/0,5Cu	11%	500g

Bestellbeispiel nach DIN:

Lotpaste (SC...) L-Sn96,5Ag3Cu0,5 / 1.2.2.C / 89 - 3 500g (Gebinde)

Solder Chemistry ; Fragnerstraße 4 ; D-84034 Landshut

Tel. ++49/871/4309500 ; Fax. ++49/871/43095020

e-Mail: info@SolderChemistry.com ; www.solderchemistry.com

Vorstehende Angaben sollen sie bestmöglich informieren. Eine Verbindlichkeit kann jedoch aufgrund der Vielseitigkeit der Materialien, Anwendungen und Arbeitsprozesse, auch im Bezug auf etwaige Schutzrechte und Verpflichtungen Dritter, nicht übernommen werden.